Elektrischer Test: 100% bestanden

Endplattenstärke: 1,8 +/- 0,15 mm

OBERFLÄCHE: DIESE BOARD WIRD IMMISSIONSGOLDIERT NACH IPC-6012.
DICKE soll 0,050 µM über 3-6 µM NICKEL sein.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN,

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen:	Vakuumverpackt
Lieferdetails:	7-10days

Fabrik: China Handy-Leiterplatten-Herstellung, Holgen kostenlose Leiterplattenhersteller China